

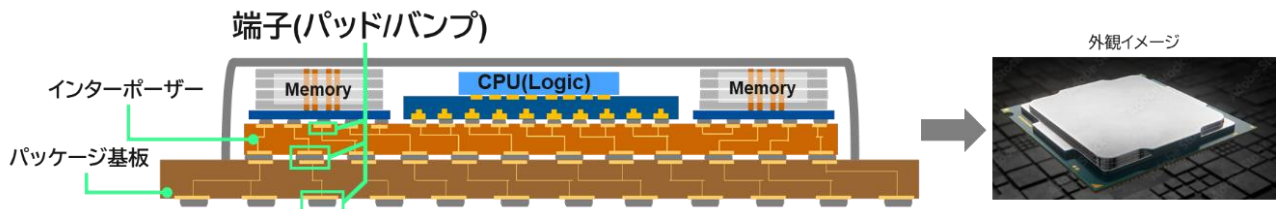


## 業界初、アドバンスドパッケージ用テスター「LIBRA」の受注を開始

当社は、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)用アドバンスドパッケージを検査する「LIBRA」の1号機を受注いたしましたので、ご案内いたします。

### <背景>

高速・低遅延で大容量のデータ処理を支える HPC 用半導体においては、数多くの CPU や HBM メモリーがインターポーザ基板を介して最も効率的に配置、接続され、一つのシステムとして生成 AI 用サーバー等へ搭載されます。その為、個々の半導体に加えインターポーザ等に対しても高水準の品質管理が求められています。



(図) HPC 用アドバンスドパッケージのイメージ

### <半導体テスター「LIBRA」>

LIBRA は、従来方式の検査で対応が不可能なほどに狭ピッチ化が急速にすすむパッケージ基板・インターポーザ(RDL)上の端子間の電気的な検査を、世界で初めて実現しました。

この装置は、配線層を積層する途中工程から完成後の最終検査までに必要とされる多種多様な検査に、独自技術を結集して開発した超微細 $\mu$ プローブを採用、量産ラインへの適用が見込まれる  $25\mu\text{m}$  ピッチ端子の4端子検査に業界で初めて対応しています。

更に、端子部への接触が物理的に困難な配線については、当社と東北大学が共同開発した非接触センサーを採用することで多岐にわたる電気検査を実現しております。

### <今後の展開について>

当社は HBM(High Bandwidth Memory、広帯域メモリー)の歩留まり向上が期待できるメモリーダイの積層前検査技術の開発にも積極的に取り組み、半導体やディスプレイ等の電子デバイスの多様な進化に寄与することで引き続き地域社会に貢献してまいります。

### <お問合せ先>

オー・エイチ・ティー株式会社

〒720-2103 広島県福山市神辺町西中条 1118-1

Tel : (084)960-2120

以上